

**2025年3月期第3四半期(2024年4月~12月)
決算説明資料**

2025年2月7日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令又は証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新又は改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信をご参照ください。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2025年3月期第3四半期連結決算概要

2025年3月期第3四半期連結決算概要

- 生成AIの普及を背景に先端DRAM向けが好調。Logic/Foundryも先端ノード向け設備投資が加速。中国成熟ノード向け設備投資は落ち着きが見られるものの、NAND向け設備投資に回復の兆し。
- 3Qは、特に世界各国向け装置販売が好調に推移し、前年同期比・前四半期比ともに増収増益。
- 3Q累計でも、前年同期比で増収増益、各利益率が上昇。

2025年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 好調な先端ノードLogic/Foundry向け、先端DRAM向けに続いて、NAND向けの回復が進む見通し。
- 2Q決算時に修正した通期業績予想に沿って推移しており、業績予想に変更なし。

連結業績サマリー

3Qは、2Q決算時に修正した業績予想に沿って推移し、前年同期比・前四半期比で増収増益。
3Q累計でも、前年同期比で増収増益となり、各利益率が上昇。

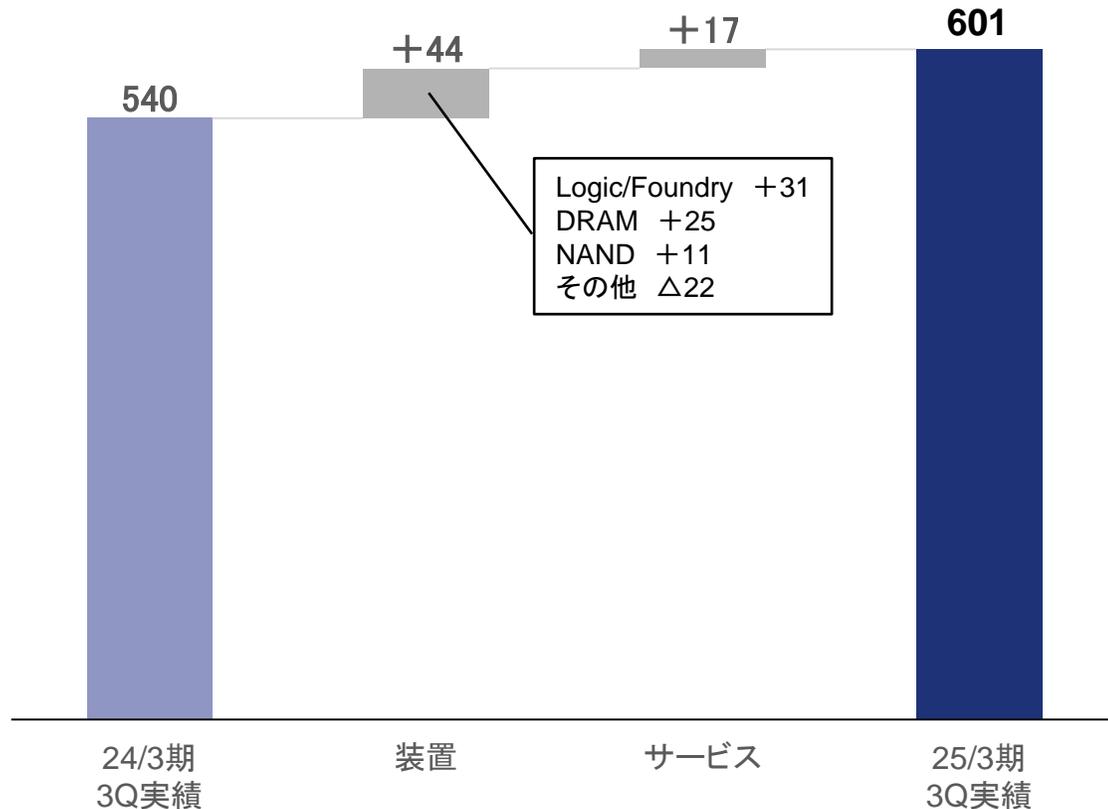
(億円)	24/3期				25/3期						
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	1Q	2Q	3Q	前年同期比	前四半期比	3Q累計	前年同期比
売上収益	327	450	540	1,317	652	493	601	+11.4%	+21.9%	1,747	+32.7%
売上総利益	143	199	217	559	294	220	249	+14.4%	+13.0%	762	+36.4%
売上総利益率	43.6%	44.2%	40.3%	42.5%	45.0%	44.6%	41.4%	+1.1pts	△3.2pts	43.6%	+1.1pts
調整後営業利益	56	110	124	290	194	113	139	+11.9%	+22.8%	446	+53.4%
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	23.0%	22.1%	29.7%	22.9%	23.1%	+0.1pts	+0.2pts	25.5%	+3.4pts
調整後当期(四半期)利益	38	73	91	202	143	73	96	+6.0%	+32.8%	313	+54.8%
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	16.9%	15.3%	22.0%	14.7%	16.0%	△0.9pts	+1.3pts	17.9%	+2.6pts
営業利益	40	94	107	241	179	96	123	+14.8%	+28.4%	397	+65.0%
営業利益率	12.2%	20.9%	19.8%	18.3%	27.4%	19.4%	20.4%	+0.6pts	+1.0pts	22.7%	+4.4pts
税引前当期(四半期)利益	37	91	107	236	177	102	112	+4.6%	+10.3%	392	+65.9%
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	19.9%	17.9%	27.2%	20.7%	18.7%	△1.2pts	△2.0pts	22.4%	+4.5pts
当期(四半期)利益	27	62	79	167	133	48	80	+1.1%	+68.5%	261	+55.8%
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	14.7%	12.7%	20.4%	9.6%	13.3%	△1.4pts	+3.7pts	14.9%	+2.2pts
研究開発費	29	30	31	90	33	39	38	+22.6%	△4.2%	110	+22.2%
設備投資額	51	21	105	176	112	30	25	△76.2%	△17.3%	167	△5.1%
減価償却費	26	27	28	81	29	30	33	+19.2%	+9.9%	93	+14.4%

2025年3月期第3四半期実績 増減要因

3Qは、装置、サービスともに前年同期比で売上が増加し、全体の売上収益は前年同期比11%増。売上総利益の上昇が販管費の増加を吸収し、調整後営業利益は前年同期比12%増。

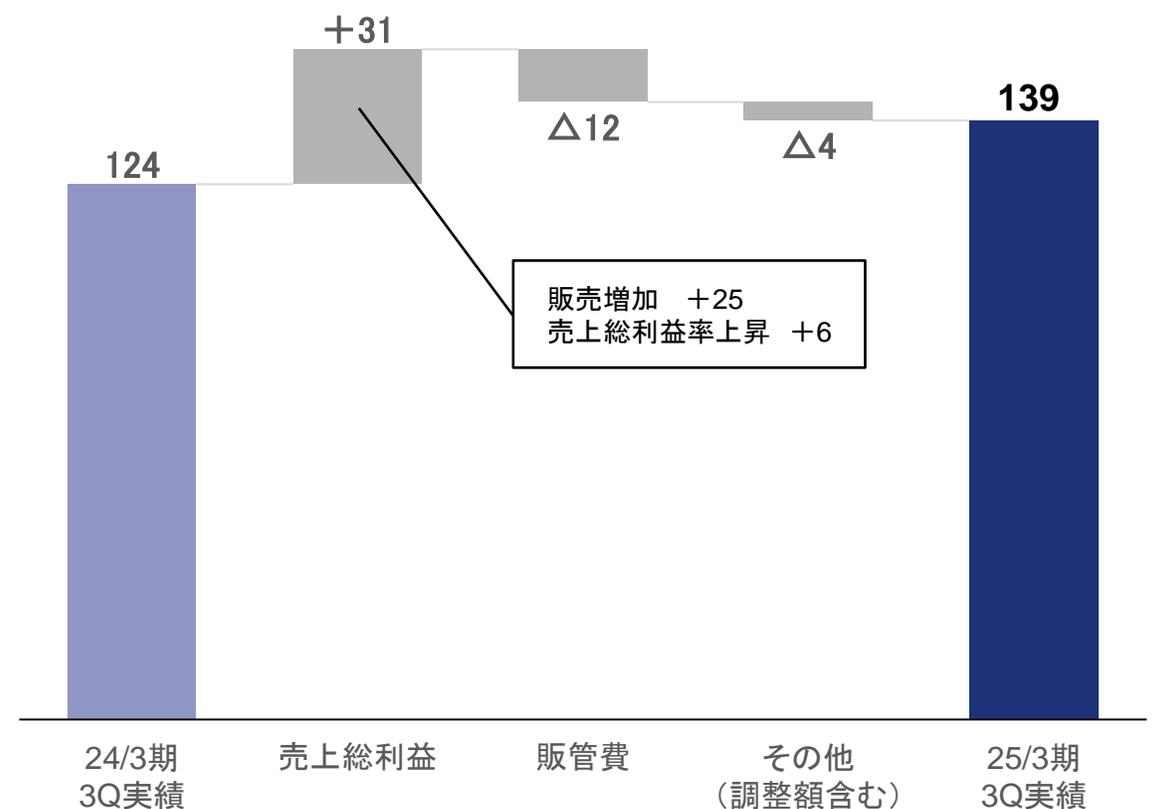
売上収益

(億円)



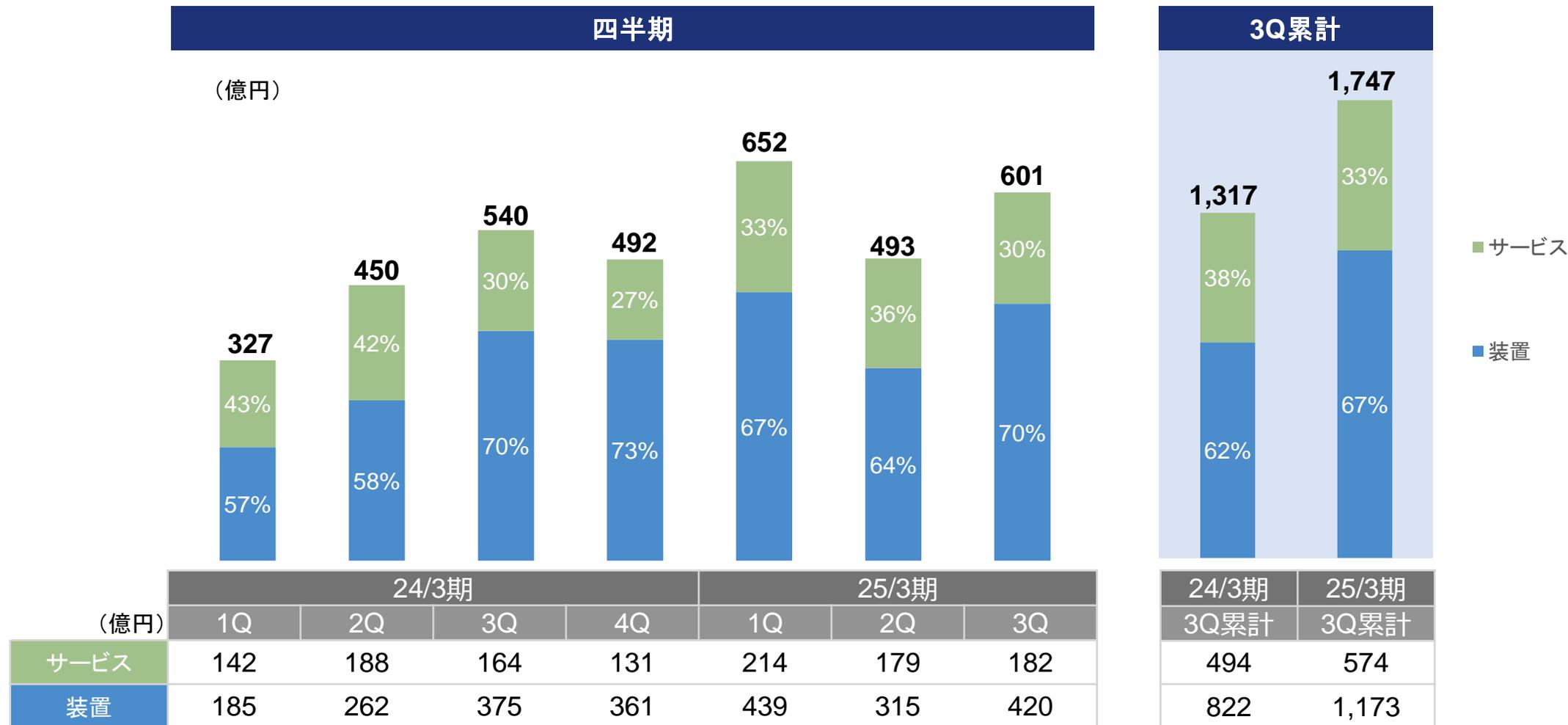
調整後営業利益

(億円)



四半期別売上収益 ビジネス別

3Qは、前年同期比で装置売上12%増、サービス売上10%増。
前四半期比では、装置売上33%増、サービス売上2%増。売上構成は平常化へ。



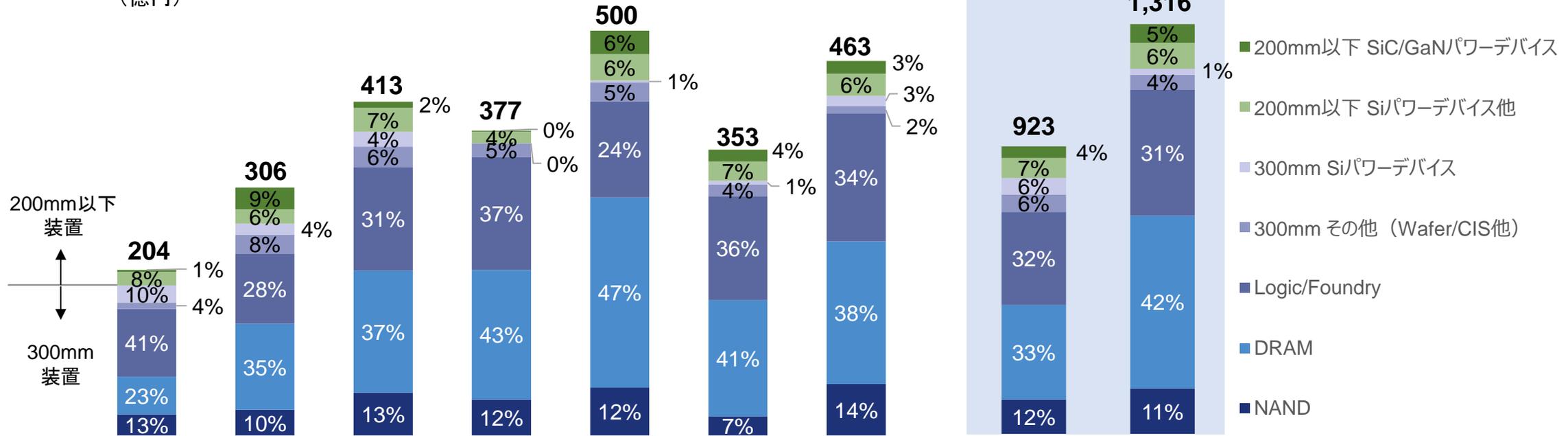
四半期別売上収益 アプリケーション別 (300mm装置 + 200mm以下装置)

3Qは、前年同期比でLogic/Foundry向け、DRAM向け、NAND向けがそれぞれ20%前後増加。
 前四半期比では、Logic/Foundry向け23%増、DRAM向け23%増、NAND向け2.7倍。

四半期

3Q累計

(億円)



24/3期 25/3期

24/3期 25/3期

(億円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
200mm以下装置	19	45	37	16	62	39	43
300mm装置	185	262	375	361	439	315	420

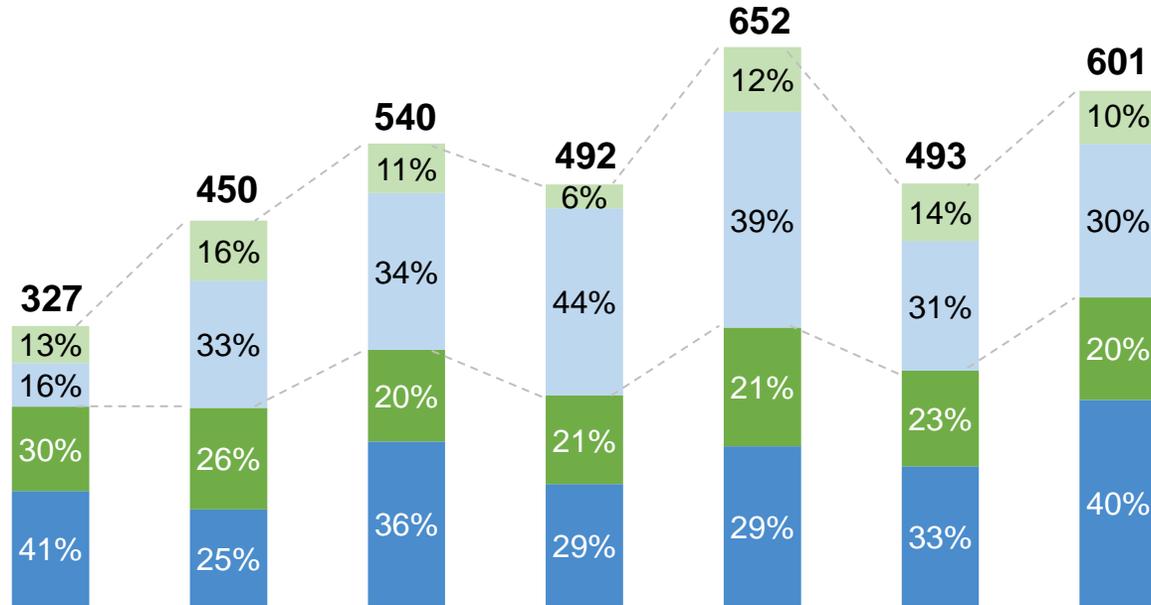
	3Q累計	3Q累計
200mm以下装置	101	143
300mm装置	822	1,173

四半期別売上収益 中国地場・世界各国別(アカウント別)

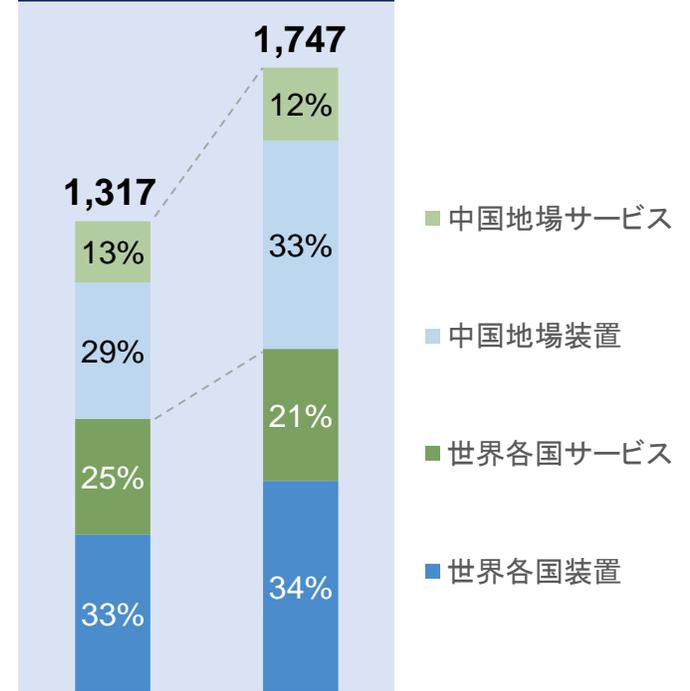
先端ノードLogic/Foundry向けと先端DRAM向けの伸長、NAND向けの回復により、世界各国向け売上が回復基調。中国地場向け売上比率は1Qをピークに低下し、3Qは40%。

四半期

(億円)



3Q累計



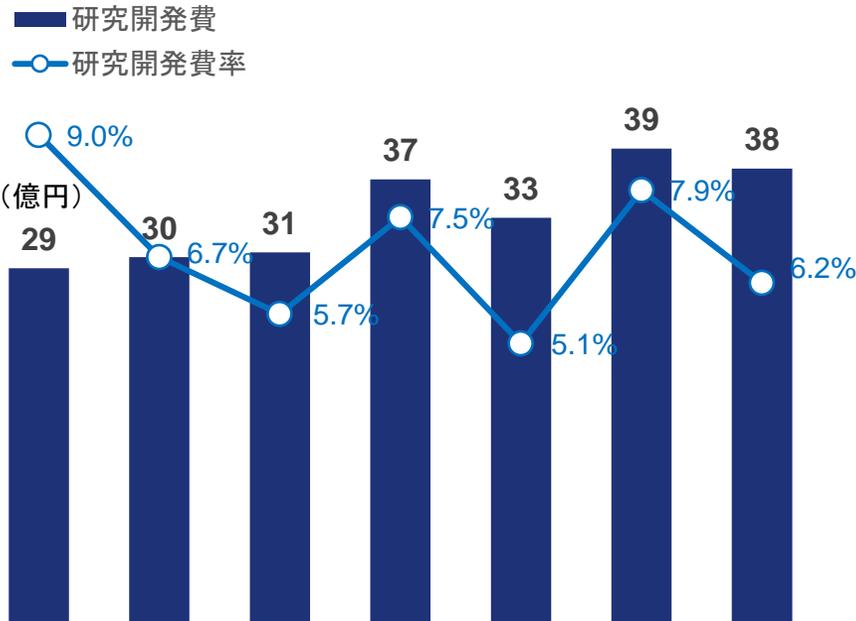
	24/3期				25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
中国地場比率	29%	49%	45%	50%	50%	44%	40%
世界各国比率	71%	51%	55%	50%	50%	56%	60%

	24/3期	25/3期
	3Q累計	3Q累計
中国地場比率	42%	45%
世界各国比率	58%	55%

四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

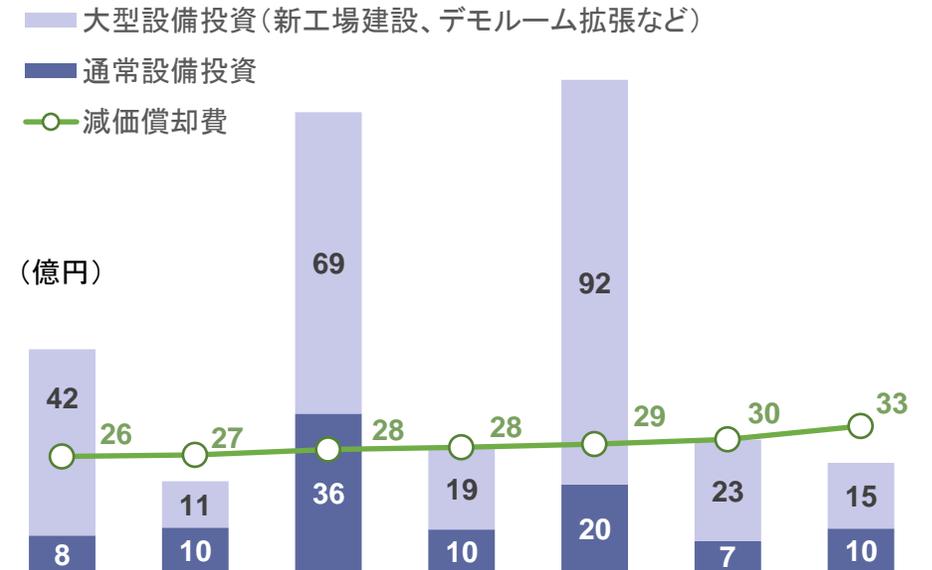
3Qの研究開発費は、次世代製品開発に向けて計画どおりに増加。
新工場建設による長期償却の大型設備投資がひと段落し、設備投資は平常化へ。

研究開発費



(億円)	24/3期				25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
研究開発費	29	30	31	37	33	39	38
売上収益比	9.0%	6.7%	5.7%	7.5%	5.1%	7.9%	6.2%

設備投資額／減価償却費

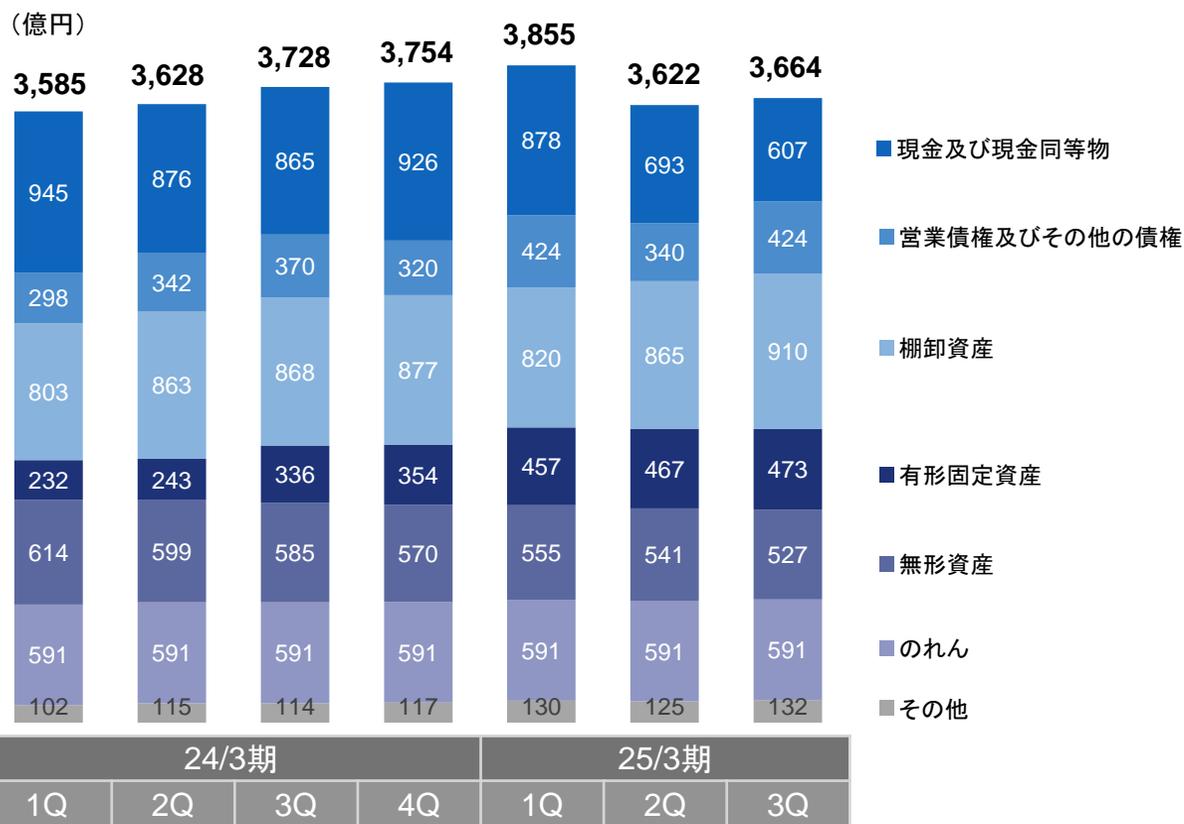


(億円)	24/3期				25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
設備投資額計	51	21	105	28	112	30	25
売上収益比	15.5%	4.6%	19.4%	5.8%	17.2%	6.1%	4.1%
減価償却費	26	27	28	28	29	30	33
売上収益比	8.1%	5.9%	5.2%	5.8%	4.5%	6.1%	5.5%

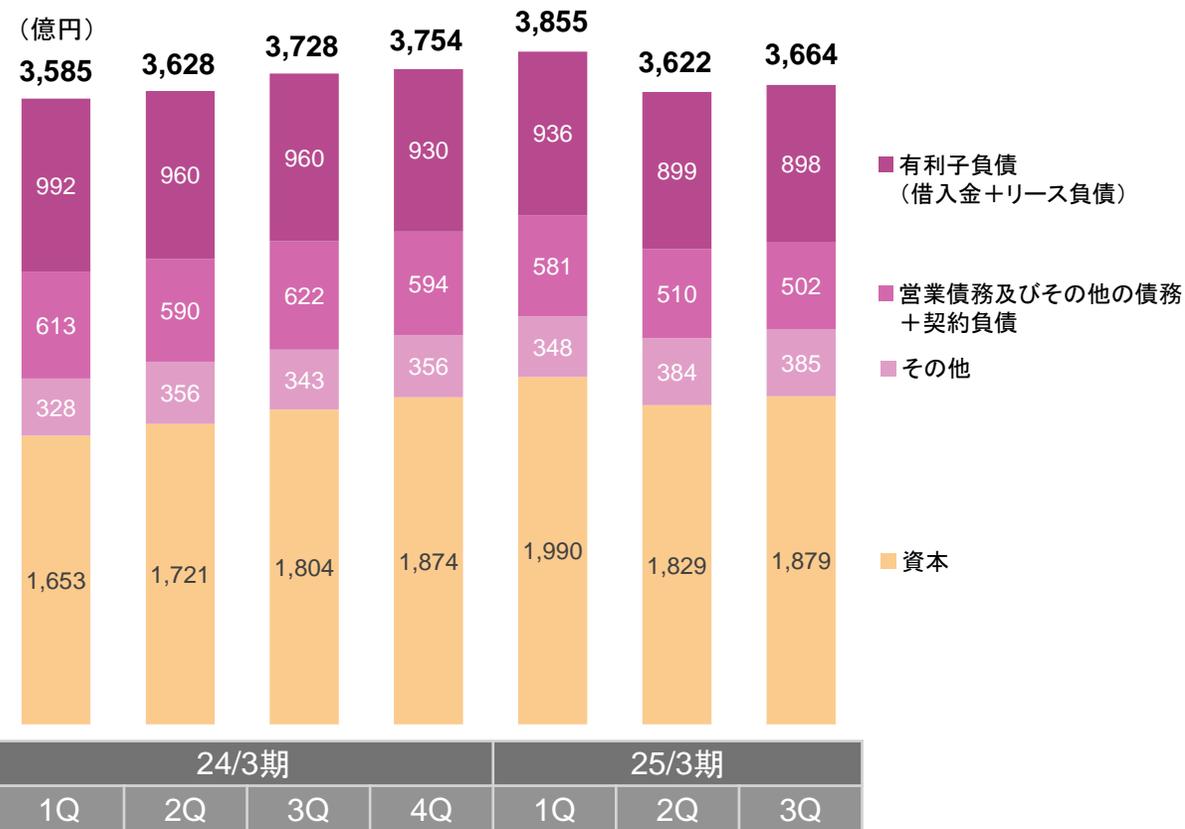
四半期別貸借対照表

3Q末の資産合計は、自己株式の取得による支出等により、前期末比で90億円減少。
 負債合計は、営業債務等の減少、借入金の返済、契約負債の減少等により、前期末比で95億円減少。
 資本合計は、利益剰余金の増加等により、前期末比で5億円増加。

資産

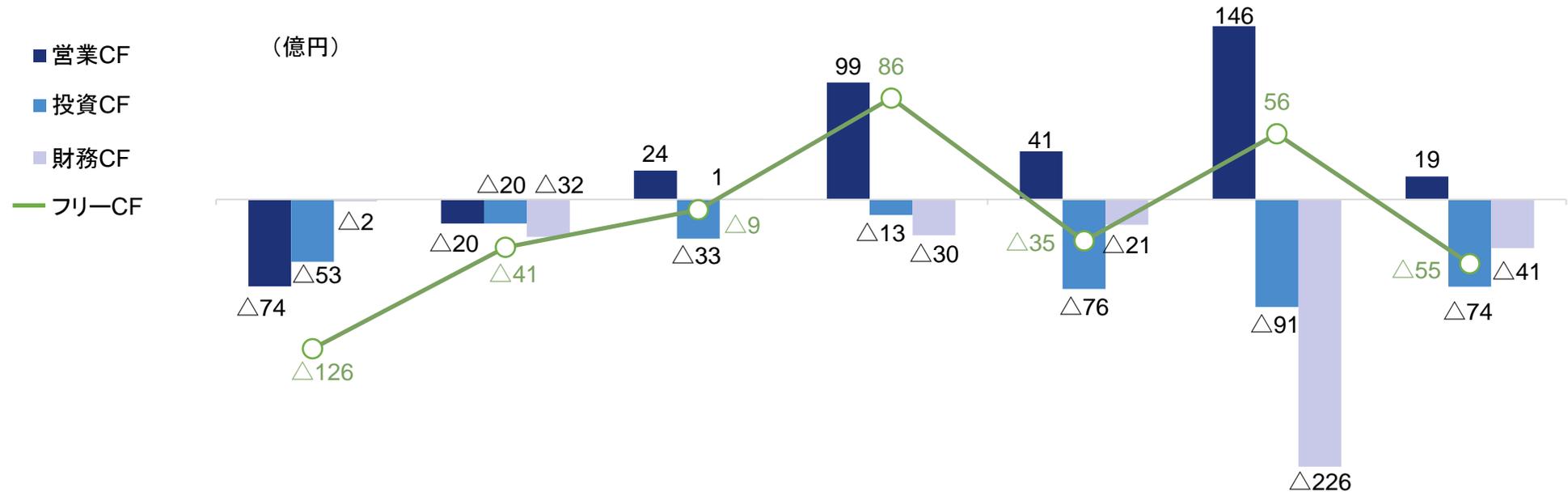


負債／資本



四半期別キャッシュ・フロー

3QのフリーCFは、有形固定資産取得等による投資CFの支出が四半期利益計上等による営業CFの収入を上回り、55億円の支出。財務CFは配当金支払い等により、41億円の支出。
現金及び現金同等物残高は、運転資金としてなお十分な水準を維持。



(億円)	24/3期				25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
営業CF	△74	△20	+24	+99	+41	+146	+19
投資CF	△53	△20	△33	△13	△76	△91	△74
財務CF	△2	△32	+1	△30	△21	△226	△41
フリーCF	△126	△41	△9	+86	△35	+56	△55
現金及び現金同等物残高	945	876	865	926	878	693	607

四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

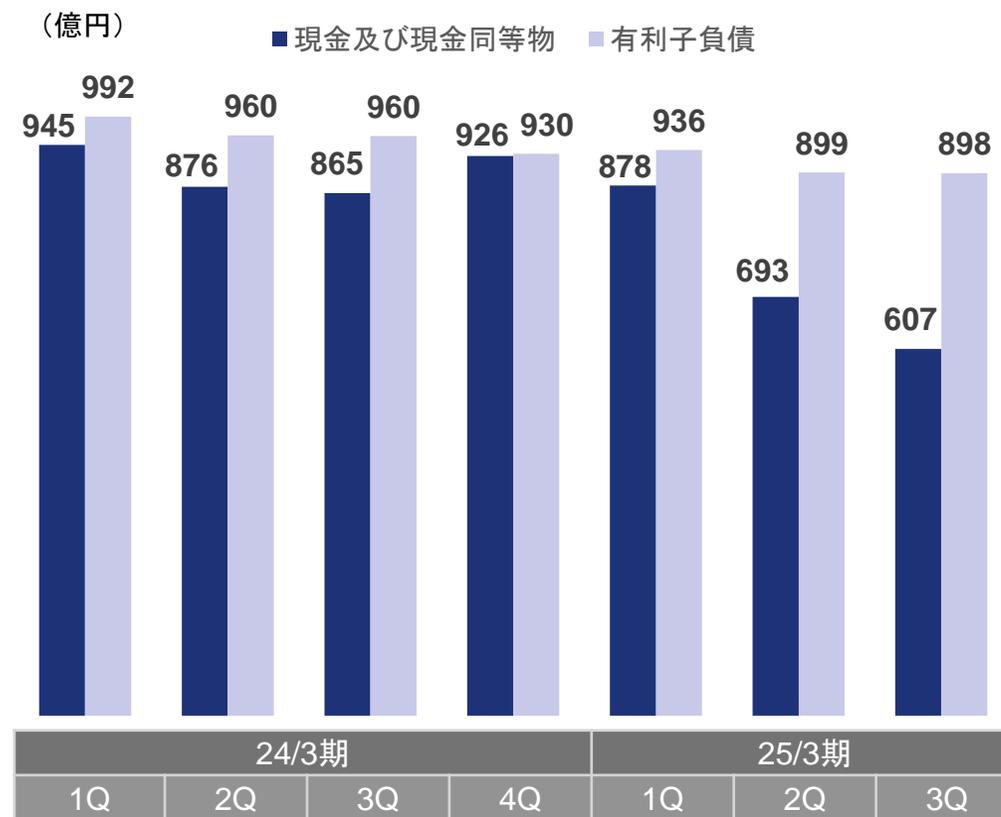
3Q末の自己資本比率は50%を超える水準を持続。

3Q末のネットデットは、自己株式の取得等により291億円に増加。

資産合計／資本合計／自己資本比率



現金及び現金同等物／有利子負債





2025年3月期連結業績予想

2025年3月期第3四半期連結決算概要

- 生成AIの普及を背景に先端DRAM向けが好調。Logic/Foundryも先端ノード向け設備投資が加速。中国成熟ノード向け設備投資は落ち着きが見られるものの、NAND向け設備投資に回復の兆し。
- 3Qは、特に世界各国向け装置販売が好調に推移し、前年同期比・前四半期比ともに増収増益。
- 3Q累計でも、前年同期比で増収増益、各利益率が上昇。

2025年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 好調な先端ノードLogic/Foundry向け、先端DRAM向けに続いて、NAND向けの回復が進む見通し。
- 2Q決算時に修正した通期業績予想に沿って推移しており、業績予想に変更なし。

2025年3月期業績・配当予想(変更なし)

2Q決算時に修正した通期業績予想・配当予想に変更なし。

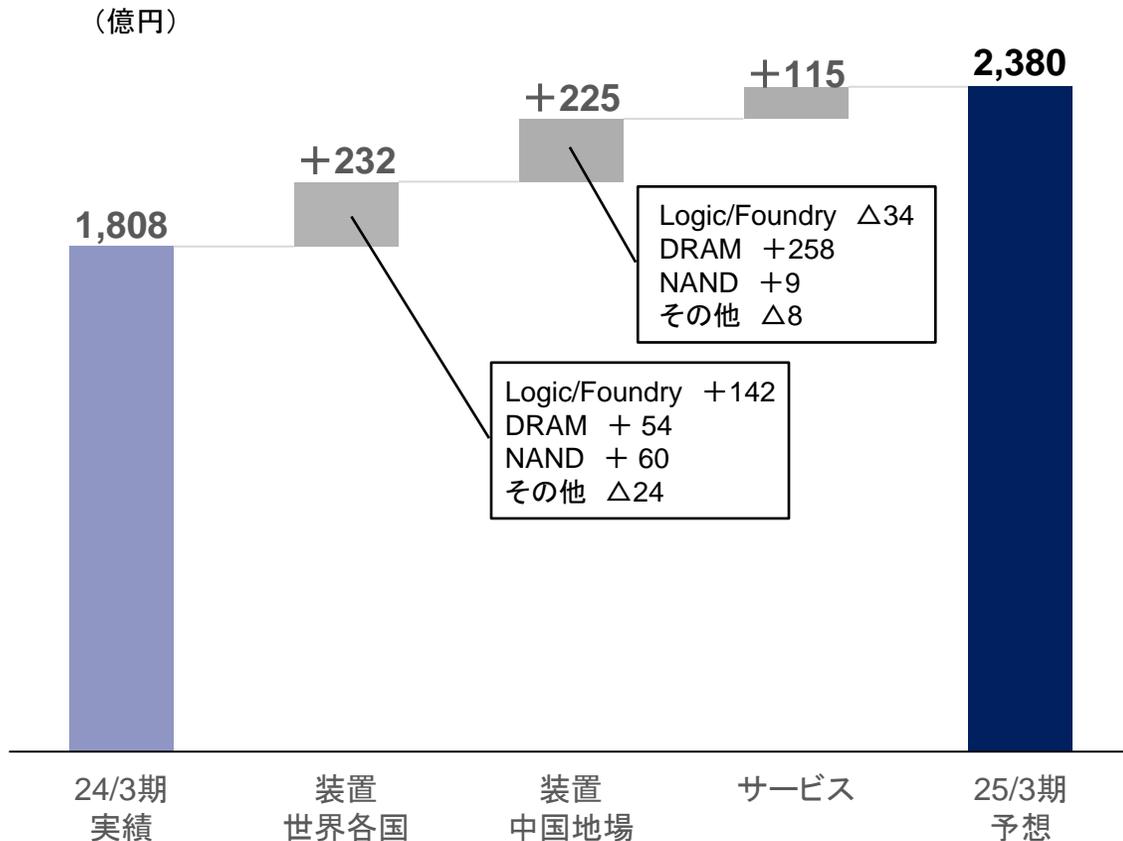
(億円)	24/3期	25/3期			
	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	前期比
売上収益	1,808	1,145	1,235	2,380	+31.6%
売上総利益	750	514	496	1,009	+34.6%
売上総利益率	41.5%	44.8%	40.1%	42.4%	+0.9pts
調整後営業利益	378	307	260	566	+49.6%
調整後営業利益率	20.9%	26.8%	21.0%	23.8%	+2.9pts
調整後当期(四半期)利益	273	216	181	396	+45.1%
調整後当期(四半期)利益率	15.1%	18.9%	14.6%	16.7%	+1.6pts
営業利益	307	274	228	502	+63.3%
営業利益率	17.0%	24.0%	18.5%	21.1%	+4.1pts
税引前当期(四半期)利益	298	279	222	501	+68.4%
税引前当期(四半期)利益率	16.5%	24.4%	18.0%	21.1%	+4.6pts
当期(四半期)利益	224	181	153	333	+48.8%
当期(四半期)利益率	12.4%	15.8%	12.4%	14.0%	+1.6pts
1株当たり配当金(円)	11 ^{*1}	18	18	36	—
配当性向(調整後当期利益ベース)	9.3%	19.2%	23.1%	21.0%	—

*1 24/3期の1株当たり配当金は、上場時期が下半期であったことを踏まえて半期分の金額としました。

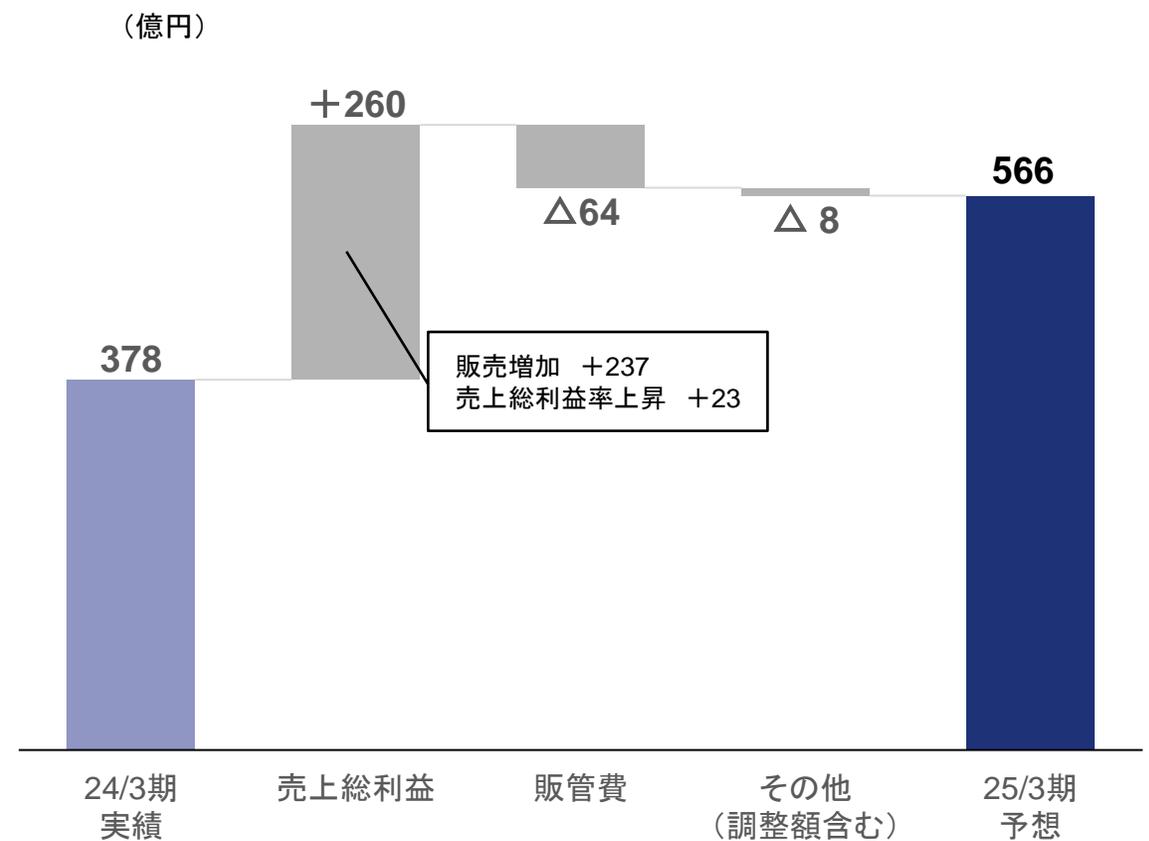
2025年3月期業績予想 増減要因(変更なし)

売上収益は、世界各国向け装置、中国地場向け装置、サービスの売上増加により前期比32%増を予想。
調整後営業利益は、売上総利益の増加と高付加価値装置販売による収益性向上により前期比50%増を予想。

売上収益

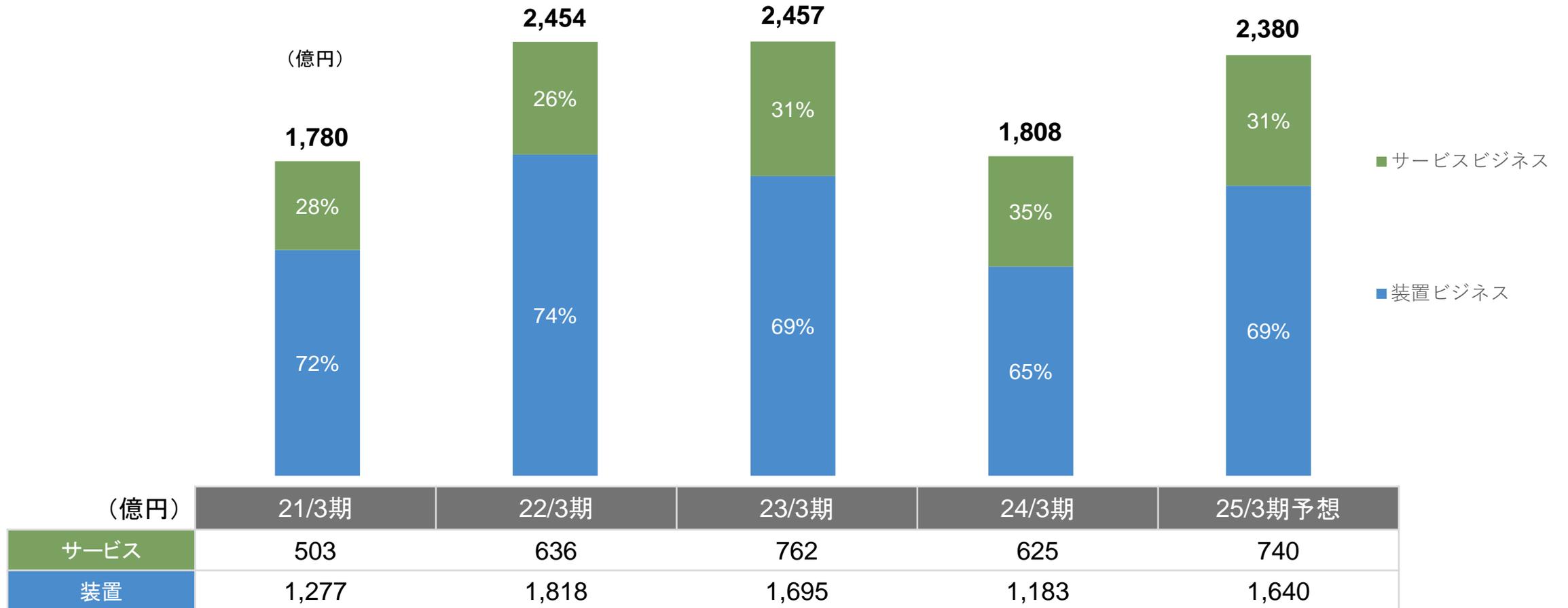


調整後営業利益



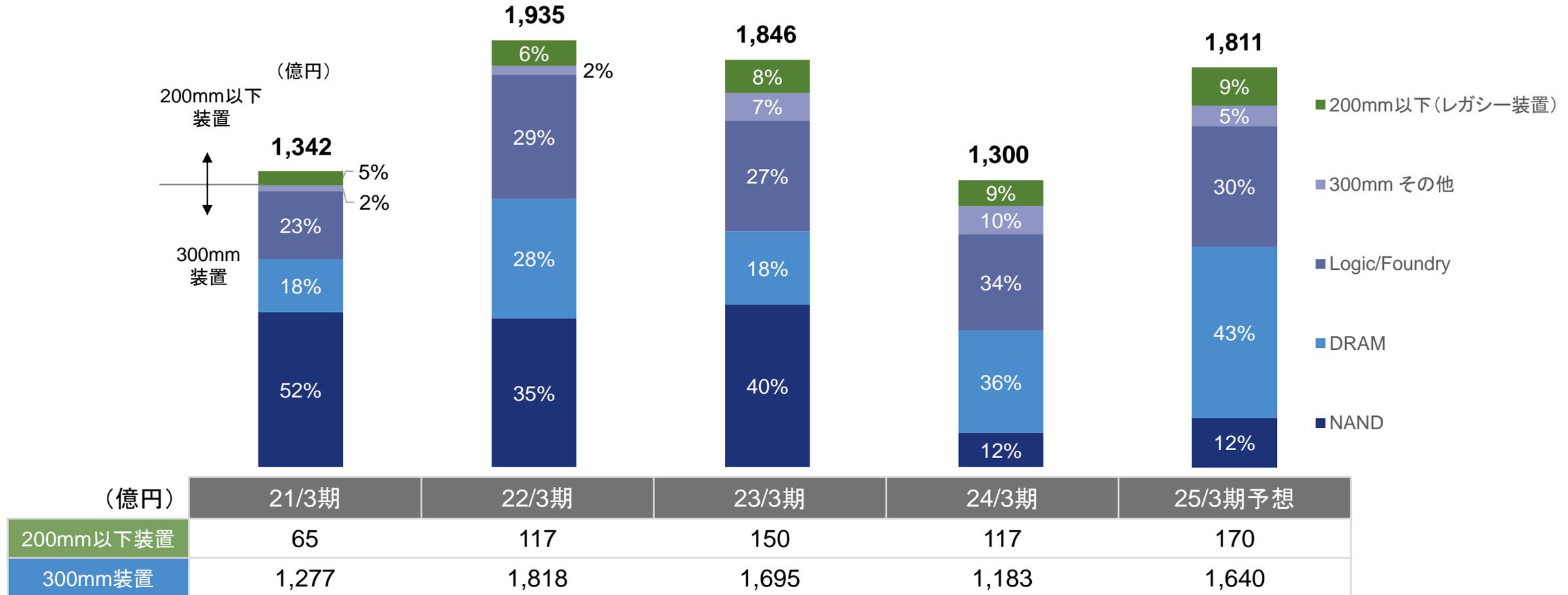
2025年3月期業績予想 ビジネス別売上収益(変更なし)

装置売上は前期比39%増、サービス売上は前期比18%増を予想。
 装置ビジネスの売上回復ペースが速まるため、売上構成比の平常化が進む見通し。



2025年3月期業績予想 アプリケーション別売上収益*1(変更なし)

前期比でLogic/Foundry向けが110億円増、DRAM向けが310億円増、NAND向けが70億円増の見通し。
GAA関連の売上は従来予想のとおり、SiCパワーデバイス関連の売上は期初予想を上振れ。



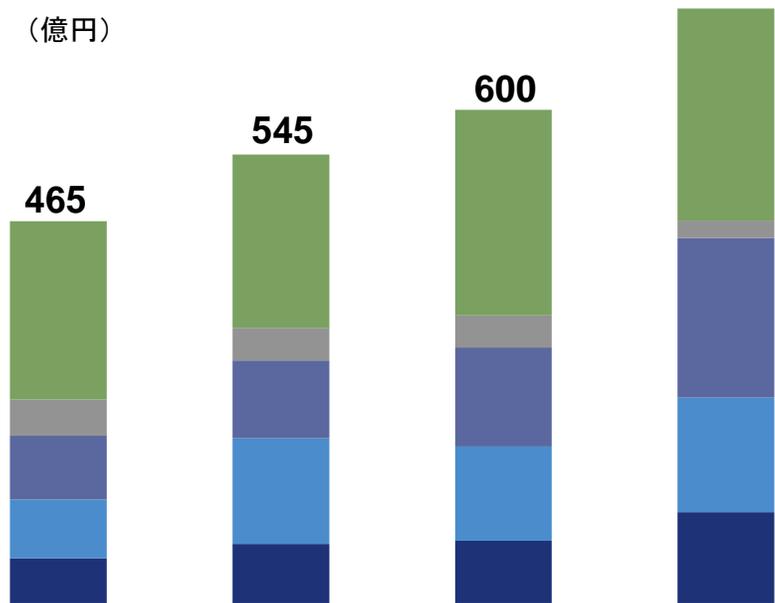
*1 300mm装置+200mm以下装置(レガシー装置)

2025年3月期業績予想 上期・下期別売上収益

25/3期世界各国向け売上はLogic/Foundry向け、DRAM向け、NAND向けが牽引し、上期から下期にかけて20%増の見通し。中国地場向け売上は上期から下期にかけて6%減の見通し。
中国地場売上比率は上期48%から下期41%へ。

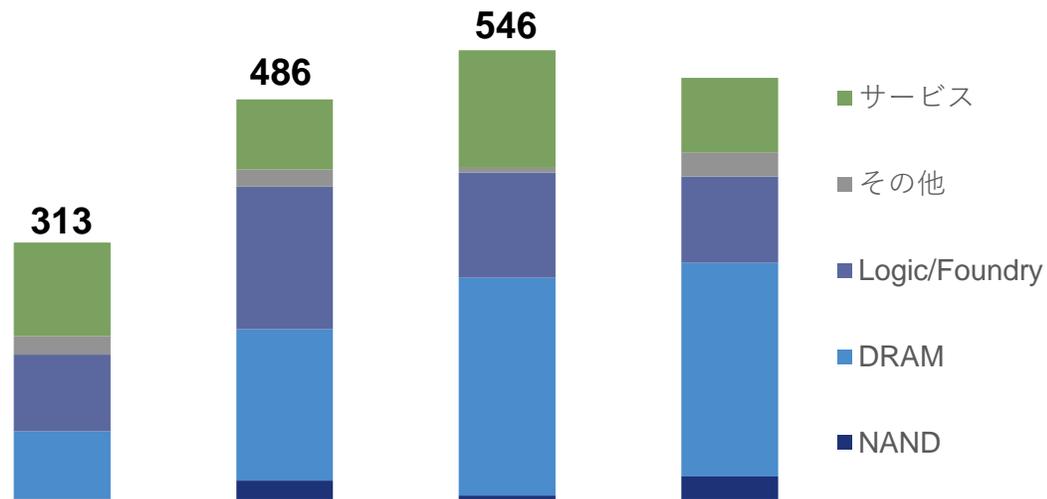
世界各国向け売上収益

(億円)



中国地場向け売上収益

(億円)





今後の見通し

事業環境の見通し

汎用DRAM、NANDの回復遅れ、成熟ノードLogic/Foundryの停滞をふまえ、2025年のWFE予想を見直し。中長期的に大きな成長を遂げるとの見方に変更なし。

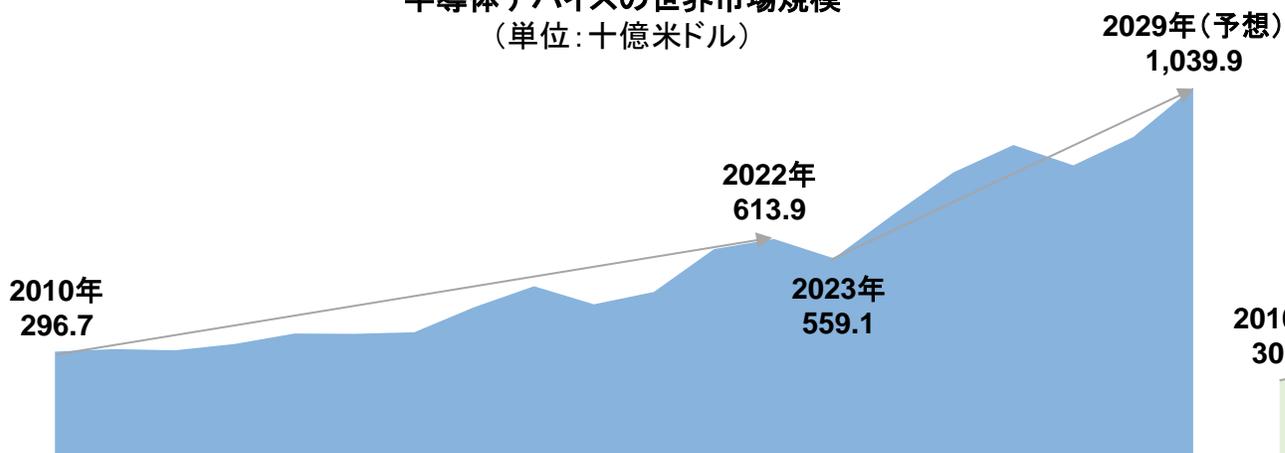
半導体デバイス市場

- 半導体デバイス市場では、生成AI関連の需要が引き続き市場をけん引し、汎用DRAMやNANDは回復に遅れ。
- 成熟ノード向けの活発な設備投資は、落ち着きが見られるものの、今後数年は相応の規模が持続する。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、環境負荷低減への投資(GX)等により、大きな成長が期待される。

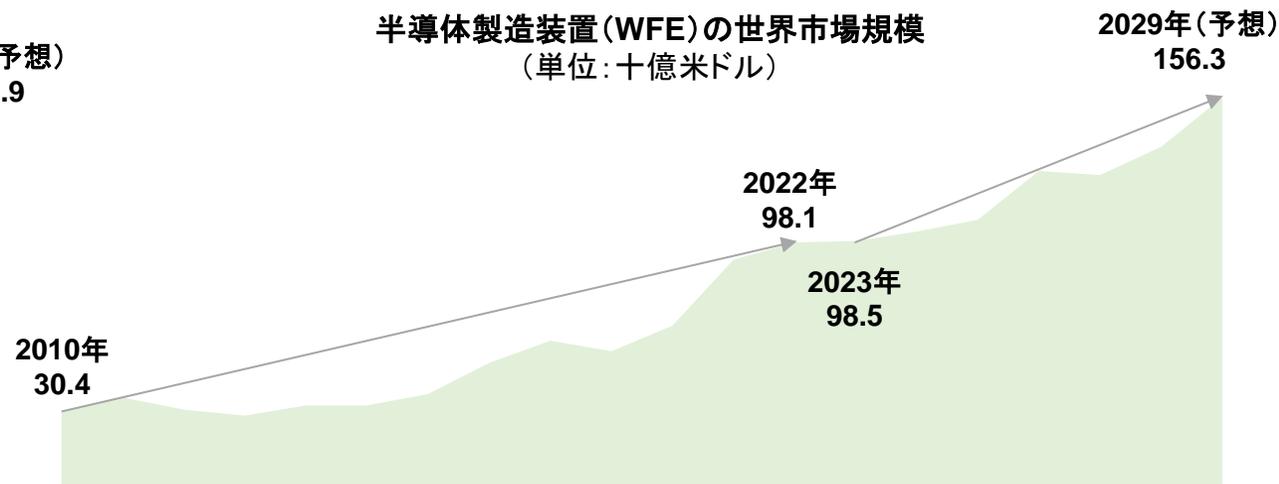
半導体製造装置(WFE)市場

- 先端デバイス向け装置需要が増加基調を継続。成熟ノード向け装置需要は落ち着き。
- WFEのCY25規模はCY24と同水準、うち世界各国向けは前年比10~20%増、中国向けは前年比20~30%減を見込む。
- 中長期的には大きな成長が期待され、今後数年で1,200億ドル程度まで成長するとの想定には変更なし。

半導体デバイスの世界市場規模
(単位:十億米ドル)



半導体製造装置(WFE)の世界市場規模
(単位:十億米ドル)



出所: TechInsights Inc. WORLDWIDE SEMICONDUCTOR HISTORY AND FORECAST (December 2024)
TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2010 - 2029) (December 2024)

アプリケーション別の事業環境と当社の状況

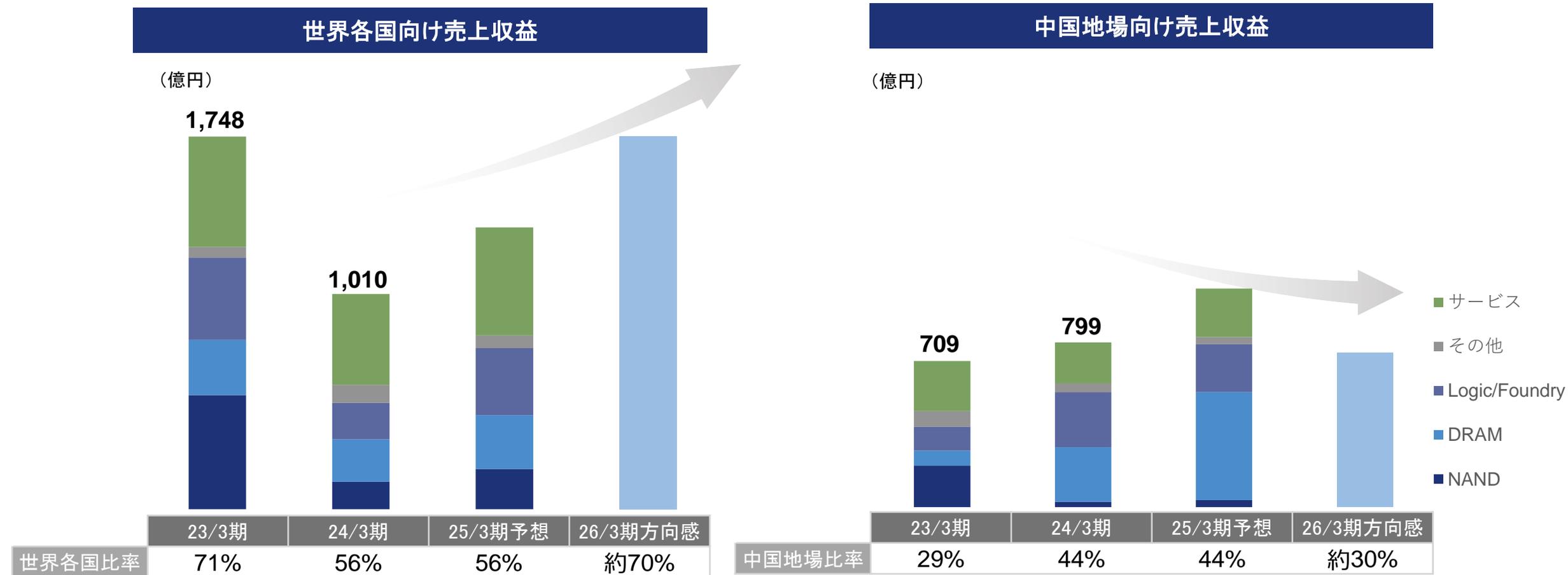
Logic/Foundry向け、DRAM向けは、世界各国向け装置需要の増加基調が続く見通し。
NAND向けは、世代交代に伴う高付加価値装置の需要が増加し、中国地場向けも回復する見通し。
各国輸出規制改正の直接影響は軽微。

	事業環境	当社
Logic/Foundry	<ul style="list-style-type: none"> 一部のデバイスメーカーで投資抑制があるものの、先端ノード向け装置需要が回復。 中国成熟ノード向け装置需要は落ち着き、欧米成熟ノード向け装置需要は一定期間、投資抑制が続く。 	<ul style="list-style-type: none"> GAA、インターポーザー向け売上は順調に増加し、先端ノード向け装置売上が増加。今後の売上拡大にも期待。 欧米成熟ノード向けはシェア拡大に向けた取り組みを継続し、需要回復に備える。
DRAM	<ul style="list-style-type: none"> 生成AIの普及によるHBM需要拡大により、先端向け装置需要が増加。 中国地場向けはデバイスメーカーの投資の濃淡により、24年は旺盛な需要があるものの、25年は需要が減少。 	<ul style="list-style-type: none"> 先端向け装置売上の増加基調が持続。D1c世代でバッチALD*1対応装置、枚葉トリートメント装置の新規POR確定。 今後のデバイス世代向け(D1d、VCT DRAM、3D Stacked DRAM)でのPOR拡大をめざす。
NAND	<ul style="list-style-type: none"> 従来の想定よりもスローペースながら、世界各国向けで世代交代に向けた装置需要が回復し始める。 中国地場向けでも需要回復の兆し。 	<ul style="list-style-type: none"> デバイス世代交代に向けてバッチALD対応装置の入れ替え・改造の売上が回復し始める見通し。 中国地場向けの装置売上も回復の見通し。
SiCパワーデバイス (サービスビジネス)	<ul style="list-style-type: none"> 高温活性化アニール装置のニーズ拡大。 ウェーハサイズが150mmから200mmに移行するのに合わせて需要拡大に期待。 	<ul style="list-style-type: none"> 高温活性化アニール新製品投入を進めつつ、既存製品の売上伸長。 ALD関連の新たなソリューション開発に注力。

*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

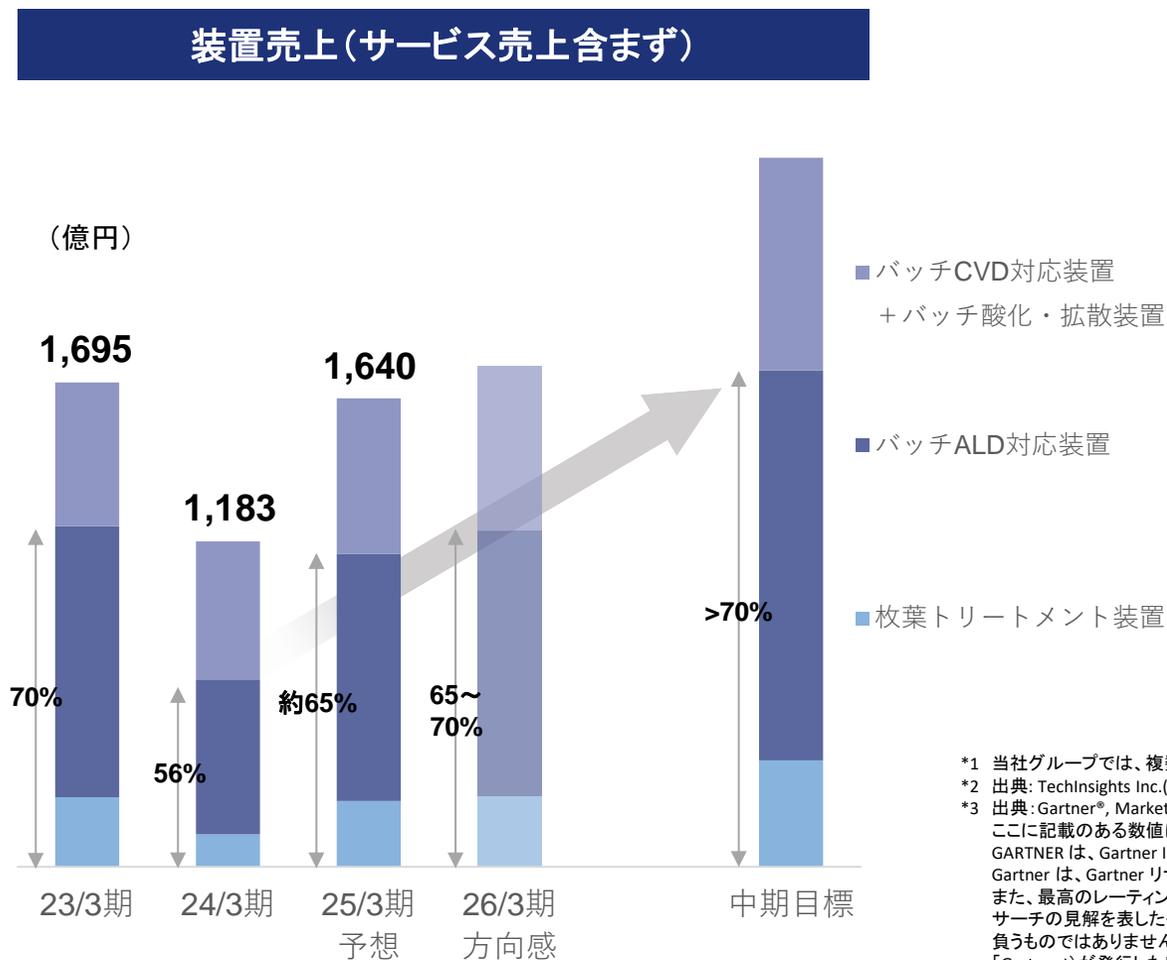
2026年3月期の方向感

CY25のWFE規模はCY24並みを想定し、26/3期は増収増益をめざす。
 世界各国向け売上は30%程度の増加、中国地場向け売上は20~30%の減少を想定。



製品構成の推移

デバイスの進化に伴い、高付加価値なバッチALD*1対応装置、枚葉トリートメント装置の構成比が拡大。高付加価値製品構成比の上昇により収益性は維持・向上へ。



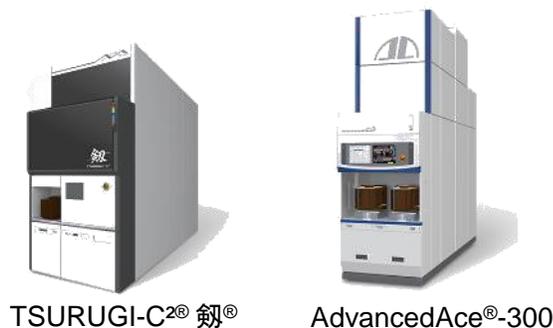
バッチ成膜装置

バッチALD対応装置

世界シェア No.1 (2023年)*2

バッチCVD対応装置

バッチ酸化・拡散装置



枚葉トリートメント装置

世界シェア No.3 (2023年)*3



*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

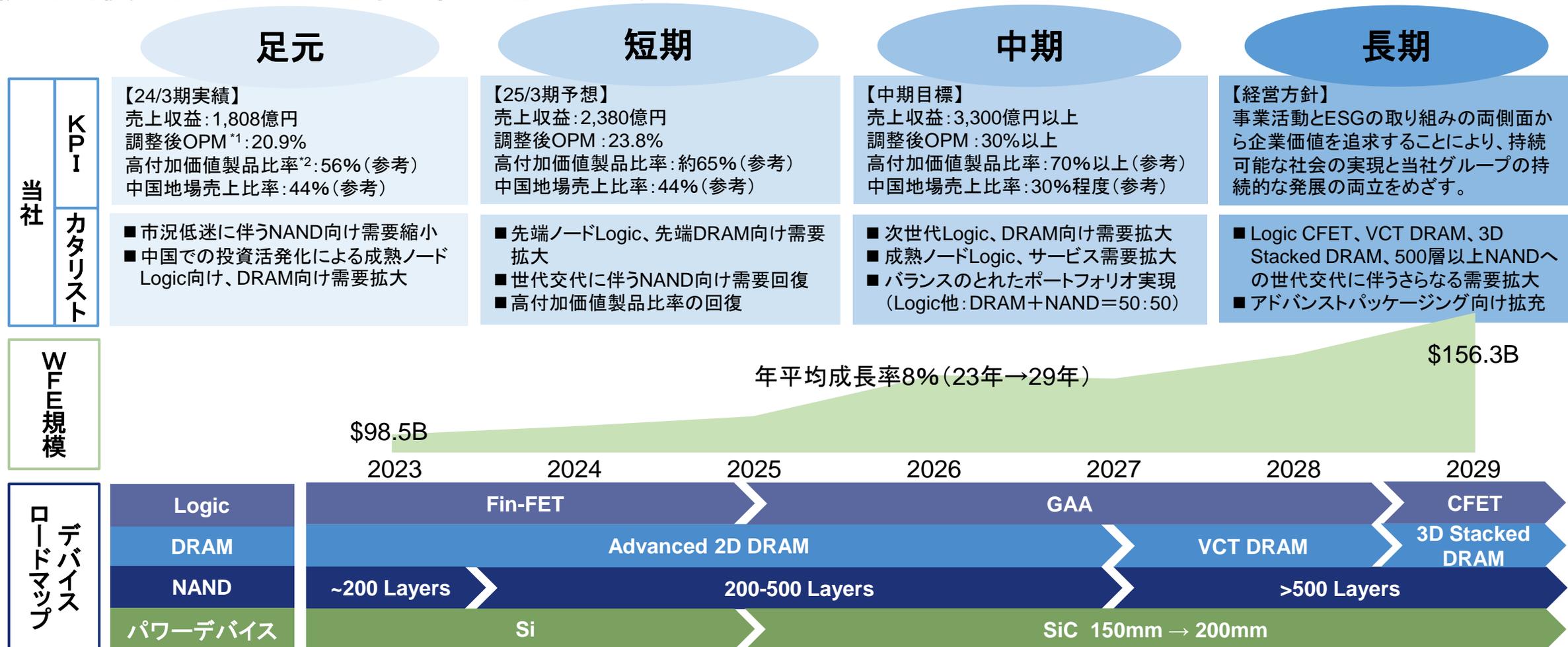
*2 出典: TechInsights Inc.(VLSI) "TI_ALD Tools_YEARLY" 2024 (April)

*3 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2023, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 1, May 2024

ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。トリートメント装置: RTP and Oxidation/Diffusion
GARTNER は、Gartner Inc. または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.
Gartner は、Gartner リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。
また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner リサーチの発行物は、Gartner リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartner は、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

まとめ

半導体デバイスの進化に伴う構造複雑化・三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして事業拡大をめざす。



出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (December 2024)

*1 OPM: 営業利益率 *2 高付加価値製品比率: 装置売上に占めるバッチALD^{*3}対応装置および枚葉トリートメント装置の売上比率 *3当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。



Appendix

4月1日付 代表取締役の異動

代表取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
塚田 和徳	代表取締役 社長執行役員	取締役 専務執行役員
金井 史幸	取締役	代表取締役 社長執行役員

※新任代表取締役の任期は本年6月27日に開催予定の当社第10期定時株主総会の終結の時までとなりますが、本株主総会に取締役候補者として付議し、その後の取締役会にて代表取締役として選定される予定です。

新任代表取締役の略歴

1986年4月	国際電気株式会社(現 株式会社国際電気)入社
2007年4月	同社 電子機械事業部 アジア営業部長
2014年4月	同社 電子機械事業部 営業本部長
2019年4月	当社 執行役員 営業本部長
2021年4月	科意半導体設備(上海)有限公司 董事長 兼 総経理
2022年4月	当社 常務執行役員
2024年4月	当社 専務執行役員
2024年6月	当社 取締役 専務執行役員(現任)



代表取締役 社長執行役員に就任する
塚田 和徳

4月1日付 執行役員体制

執行役員体制

氏名	役位	管掌
塚田 和徳(昇任)	社長執行役員	業務執行の統括および経営企画、広報・IR 管掌
柳川 秀宏(重任)	専務執行役員	事業開発担当およびDX・IT、情報セキュリティ統括
山田 正行(重任)	常務執行役員	生産、調達、品質保証、輸出管理担当および事業所運営統括
河上 好隆(重任)	常務執行役員	経理・財務担当
金山 健司(重任)	常務執行役員	技術統括およびプロセス技術開発、知財担当
山峯 直利(重任)	常務執行役員	サービス、フィールドエンジニアリング、グループガバナンス担当
宮本 正巳(昇任)	常務執行役員	営業担当
小竹 繁(重任)	執行役員	システム技術開発、量産設計担当
川上 晴彦(重任)	執行役員	人事総務、法務、サステナビリティ、倫理・コンプライアンス担当
本間 靖之(新任)	執行役員	DX・IT、情報セキュリティ担当

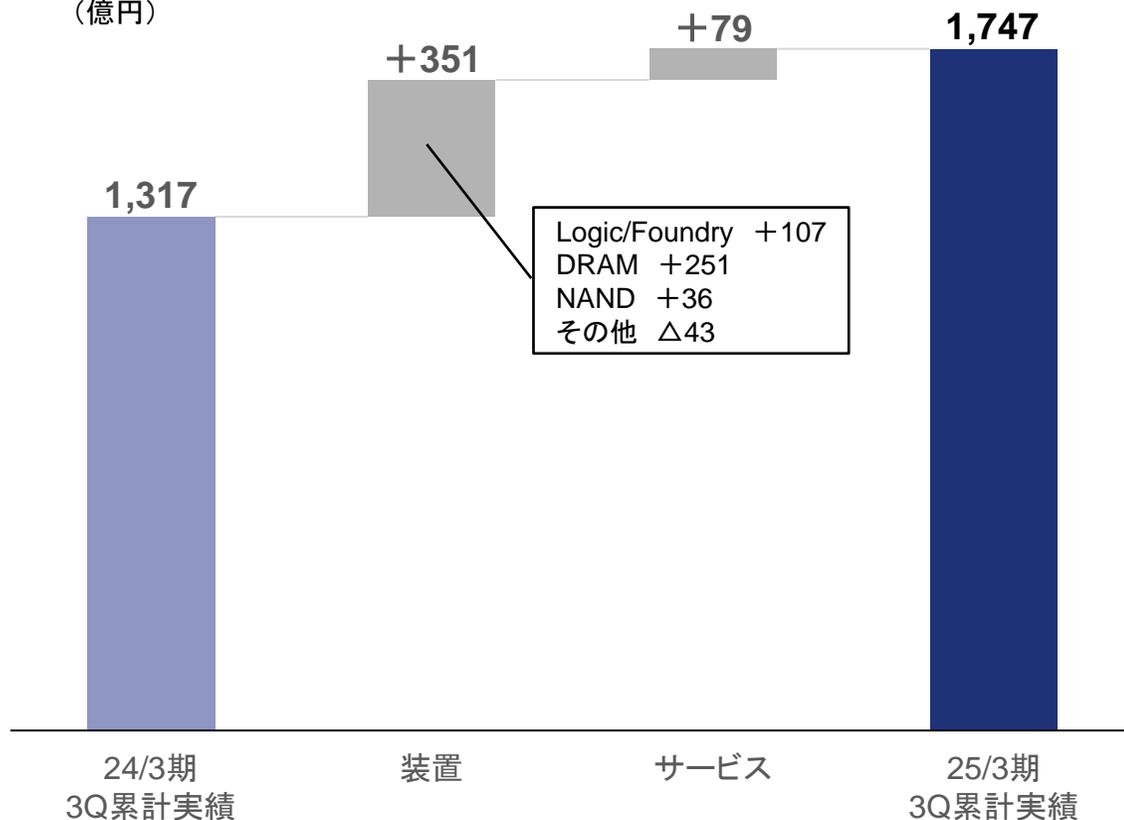
※下線は、変更となる役位および管掌です。

2025年3月期第3四半期(累計)実績 増減要因

3Q累計は、Logic/Foundry向け、DRAM向け、NAND向けで装置販売が増加し、全体の売上収益は前年同期比で33%増。販売増加と売上総利益率の上昇により、調整後営業利益は前年同期比で53%増。

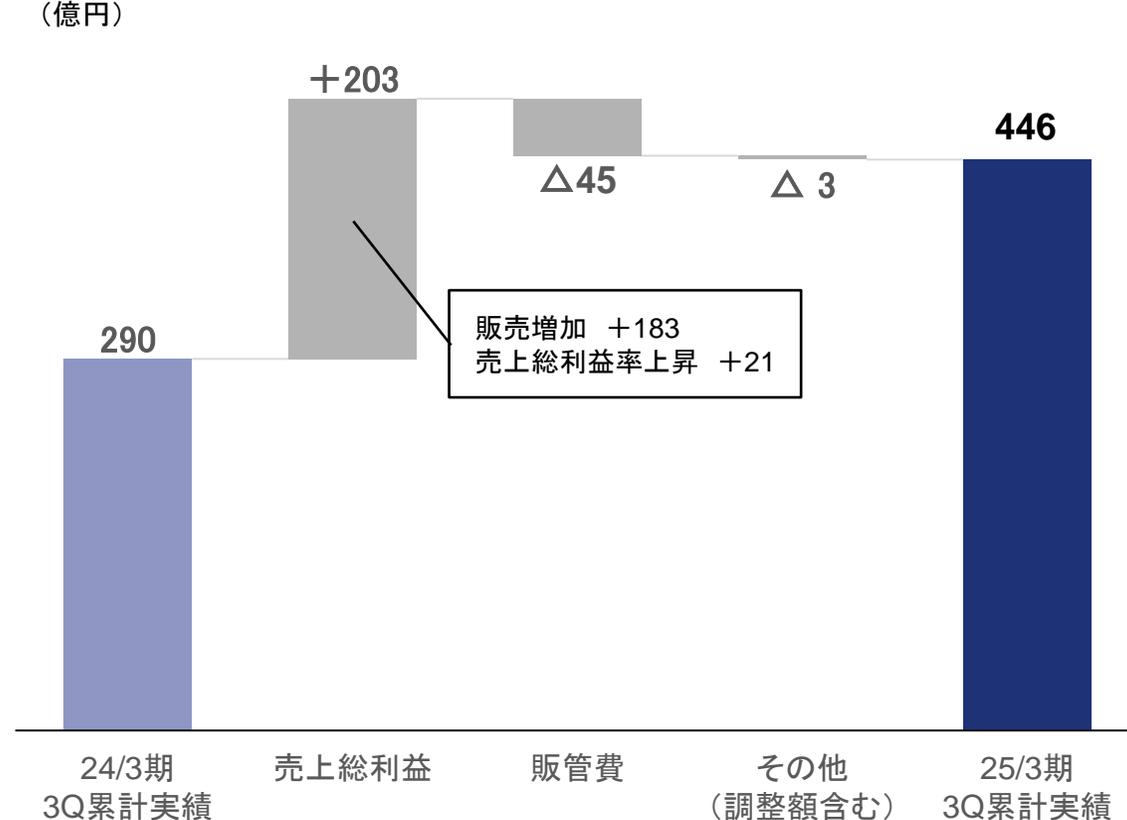
売上収益

(億円)

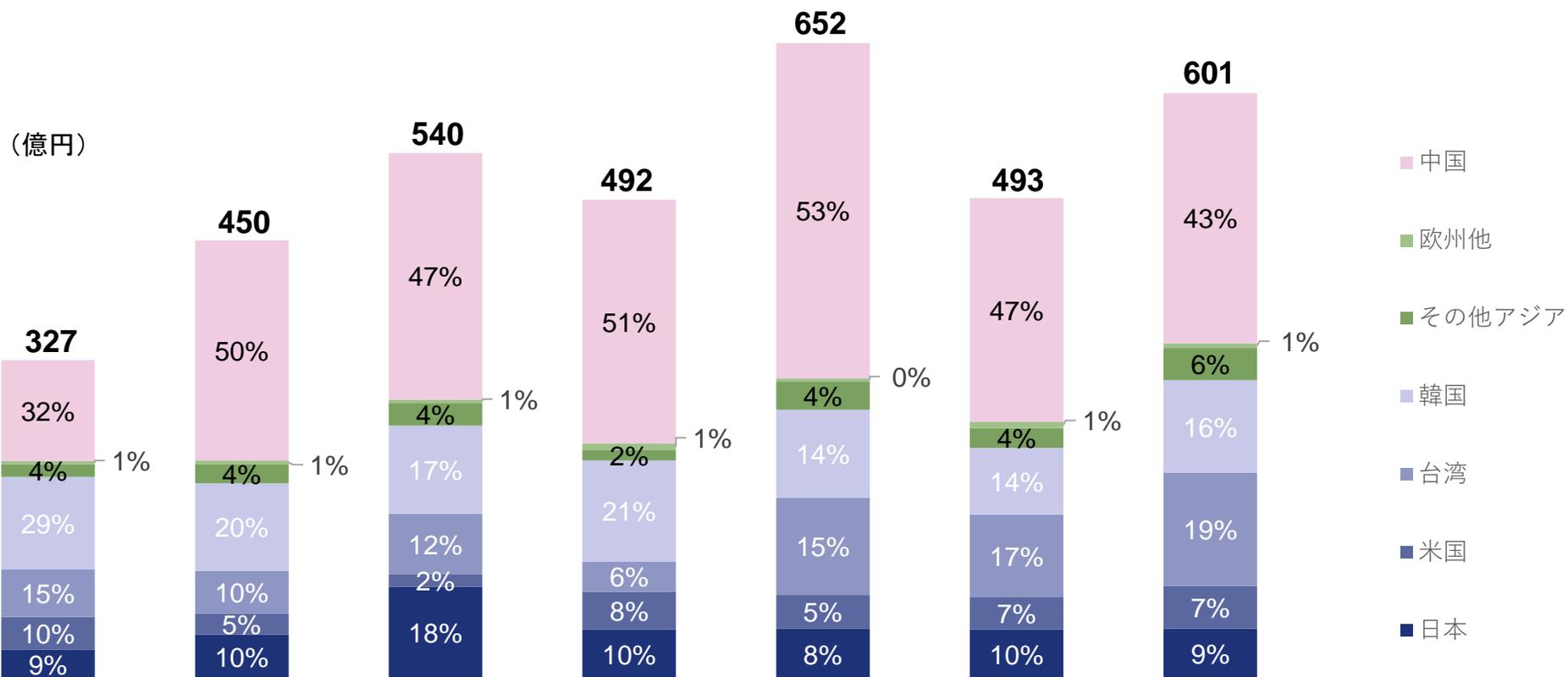


調整後営業利益

(億円)



四半期別売上収益 地域別(仕向地別)



(億円)	24/3期				25/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
海外向け	297	405	445	441	601	443	549
日本向け	30	45	94	51	51	50	52

損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	24/3期						25/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
売上収益	32,710	44,995	53,956	131,661	49,177	180,838	65,224	49,324	60,117	174,665
売上総利益	14,275	19,890	21,741	55,906	19,059	74,965	29,354	22,012	24,865	76,231
売上総利益率	43.6%	44.2%	40.3%	42.5%	38.8%	41.5%	45.0%	44.6%	41.4%	43.6%
調整後営業利益	5,614	11,035	12,400	29,049	8,790	37,839	19,382	11,299	13,876	44,557
調整後営業利益率	17.2%	24.5%	23.0%	22.1%	17.9%	20.9%	29.7%	22.9%	23.1%	25.5%
調整後当期(四半期)利益	3,782	7,304	9,101	20,187	7,109	27,296	14,345	7,262	9,646	31,253
調整後当期(四半期)利益率	11.6%	16.2%	16.9%	15.3%	14.5%	15.1%	22.0%	14.7%	16.0%	17.9%
営業利益	3,990	9,383	10,689	24,062	6,683	30,745	17,878	9,562	12,274	39,714
営業利益率	12.2%	20.9%	19.8%	18.3%	13.6%	17.0%	27.4%	19.4%	20.4%	22.7%
税引前当期(四半期)利益	3,727	9,145	10,742	23,614	6,143	29,757	17,747	10,195	11,241	39,183
税引前当期(四半期)利益率	11.4%	20.3%	19.9%	17.9%	12.5%	16.5%	27.2%	20.7%	18.7%	22.4%
当期(四半期)利益	2,655	6,158	7,914	16,727	5,647	22,374	13,302	4,751	8,004	26,057
当期(四半期)利益率	8.1%	13.7%	14.7%	12.7%	11.5%	12.4%	20.4%	9.6%	13.3%	14.9%
研究開発費	2,932	3,023	3,062	9,017	3,666	12,683	3,348	3,920	3,755	11,023
設備投資額	5,077	2,071	10,478	17,626	2,828	20,454	11,215	3,015	2,494	16,724
減価償却費	2,637	2,671	2,792	8,100	2,845	10,945	2,914	3,027	3,327	9,268

調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	24/3期						25/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
営業利益	3,990	9,383	10,689	24,062	6,683	30,745	17,878	9,562	12,274	39,714
－その他の収益	△30	△110	△285	△425	△254	△679	△92	△187	△28	△307
＋その他の費用	45	33	19	97	390	487	27	78	79	184
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	4,777	1,592	6,369	1,479	1,477	1,475	4,431
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	214	9	223	12	298	3	313
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	324	370	694	78	71	73	222
調整額 計	1,609	1,729	1,977	5,315	1,971	7,286	1,569	1,846	1,551	4,966
調整後営業利益	5,614	11,035	12,400	29,049	8,790	37,839	19,382	11,299	13,876	44,557
当期(四半期)利益	2,655	6,158	7,914	16,727	5,647	22,374	13,302	4,751	8,004	26,057
－その他の収益	△30	△110	△285	△425	△254	△679	△92	△187	△28	△307
＋その他の費用	45	33	19	97	390	487	27	78	79	184
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,592	1,592	1,593	4,777	1,592	6,369	1,479	1,477	1,475	4,431
＋スタンドアローン関連費用	1	10	203	214	9	223	12	298	3	313
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	16	127	181	324	370	694	78	71	73	222
－調整項目に対する税金調整額	△497	△506	△524	△1,527	△645	△2,172	△461	△531	△491	△1,483
＋一時的な税金費用の調整額	-	-	-	-	-	-	-	1,305	531	1,836
調整後当期(四半期)利益	3,782	7,304	9,101	20,187	7,109	27,296	14,345	7,262	9,646	31,253

貸借対照表及び主要財務指標

(百万円)		24/3期		25/3期			(百万円)		24/3期		25/3期				
		3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末			3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末		
資産	流動資産	現金及び現金同等物	86,498	92,619	87,775	69,333	60,722	負債	流動負債	借入金＋リース負債	7,256	8,019	8,055	8,843	8,843
		営業債権及びその他の債権	36,963	31,994	42,444	33,979	42,369			営業債務及びその他の債務	37,777	36,667	38,657	31,275	30,328
		棚卸資産	86,820	87,682	82,028	86,542	91,019			契約負債	24,427	22,719	19,394	19,734	19,822
		その他	3,096	2,619	2,787	1,923	1,923			その他	15,841	20,138	19,554	22,510	23,180
		流動資産合計	213,377	214,914	215,034	191,777	196,033			流動負債合計	85,301	87,543	85,660	82,362	82,173
	非流動資産	有形固定資産	33,556	35,382	45,696	46,714	47,341		非流動負債	借入金＋リース負債	88,696	84,999	85,555	81,059	80,982
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065			その他	18,445	15,503	15,199	15,900	15,344
		無形資産	58,475	56,995	55,480	54,073	52,652			非流動負債合計	107,141	100,502	100,754	96,959	96,326
		その他	8,323	9,077	10,179	10,609	11,309			負債合計	192,442	188,045	186,414	179,321	178,499
		非流動資産合計	159,419	160,519	170,420	170,461	170,367			資本合計	180,354	187,388	199,040	182,917	187,901
資産合計	372,796	375,433	385,454	362,238	366,400	負債及び資本合計	372,796	375,433	385,454	362,238	366,400				

	24/3期		25/3期		
	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末
自己資本比率	48.4%	49.9%	51.6%	50.5%	51.3%
D/Eレシオ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 9,454	△ 399	△ 5,835	△ 20,569	△ 29,103

キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	24/3期						25/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,365	△ 2,030	2,443	△ 6,952	9,894	2,942	4,073	14,649	1,936	20,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,278	△ 2,037	△ 3,321	△ 10,636	△ 1,314	△ 11,950	△ 7,582	△ 9,090	△ 7,393	△ 24,065
フリー・キャッシュ・フロー	△ 12,643	△ 4,067	△ 878	△ 17,588	8,580	△ 9,008	△ 3,509	5,559	△ 5,457	△ 3,407
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167	△ 3,171	70	△ 3,268	△ 3,044	△ 6,312	△ 2,143	△ 22,628	△ 4,128	△ 28,899
現金及び現金同等物の期首残高	106,053	94,493	87,550	106,053	86,498	106,053	92,619	87,775	69,333	92,619
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,493	87,550	86,498	86,498	92,619	92,619	87,775	69,333	60,722	60,722

2025年3月期第3四半期の主な活動報告

経営・事業活動

- SEMICON® JAPAN 2024に出展。(24/12)
- KOKUSAI ELECTRIC 社員持株会を設立。(24/11)
- SK hynixの「Best Partner Award」で「優秀協力会社」を受賞。(24/11)
- SEMICON® EUROPA 2024に出展。(24/11)
- 新工場「砺波事業所」が稼働開始。(24/10)
- 当社初となる統合報告書を発行。(24/10)



各地域のSEMICON®に出展

ESGの取り組み

- 「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」の構成銘柄に選定。(24/11)
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書を更新。(24/11)
- 地域貢献活動の一環として環境教室を実施。(24/10)
- 砺波事業所で「とやま水の郷でんき」を導入。(24/10)



MSCI ESG格付けにおいて「AA」評価を獲得

*1 THE USE BY KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES ("MSCI") DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS AND ARE PROVIDED 'AS-IS' AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

2025年3月期第2四半期までの主な活動報告 経営・事業活動

- 新工場「砺波事業所」の竣工式を開催。(24/9)
- 第85回 応用物理学会 秋季学術講演会、ADMETA Plus 2024に協賛。(24/9)
- SEMICON® TAIWAN 2024に出展。(24/9)
- 2024 International Conference on Solid State Devices and Materials にプラチナスポンサーとして協賛。(24/8)
- 自己株式(5,058,400株)の取得完了。(24/9)
- 当社普通株式(60,381,700株)の売出し完了。(24/7)
- SEMICON® WEST 2024に出展。(24/7)
- 「FTSE Global Equity Index Series」構成銘柄に当社が採用。(24/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査で「10 BEST Suppliers」と「THE BEST Suppliers」を受賞。(24/5)
- PSMCの新工場開所式で感謝状を受領。(24/5)



10月から稼働した砺波事業所の竣工式を開催



「SEMICON® WEST 2024」「SEMICON® TAIWAN 2024」に出展

2025年3月期第2四半期までの主な活動報告 ESGの取り組み

- 「とやま女性活躍企業」に認定。(24/9)
- 富山市八尾町で開催された「おわら風の盆」に協賛。(24/9)
- 献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰を受賞。(24/7)
- 富山事業所がRBAのVAP監査で最高評価のプラチナ・ステータスを取得。(24/6)
- 地域貢献活動の一環として保育所施設で青空環境教室を実施。(24/5)
- 「WOMEN IN SEMICONDUCTORS」でゲストプレゼンテーションを実施。(24/5)
- 富山県砺波市で開催された「2024となみチューリップフェア」に協賛。(24/4)



©(公社)とやま観光推進機構



富山事業所が拠点を構える富山市八尾町で開催される
おわら風の盆に協賛



「とやま女性活躍企業」の認定マーク



献血運動推進協力団体厚生労働大臣表彰を受賞

用語集

- バッチ成膜装置：多数のウェーハを一括処理するバッチ方式により成膜を行う装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE : Wafer Fab Equipmentの略

